合肥通富微电子有限公司存储器芯片封装生产线扩产项目

竣工环境保护验收意见

2026 年 10 月 14 日，合肥通富微电子有限公司组织召开了存储器芯片封装生产线扩产项目竣工环境保护验收会。与会代表查看了项目现场及周边环境，并根据合肥通富微电子有限公司存储器芯片封装生产线扩产项目检测报告及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评【2017】4 号，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

合肥通富微电子有限公司存储器芯片封装生产线扩产项目建设地点位于合肥经济技术开发区卫星路 578 号，为扩建项目。本次验收在现有 1#厂房二层空置区域，新增集成电路封装塑封系统、集成电路测试机等设备，依托三期项目的污染防治设施以及厂区部分公辅设施，从事封装芯片的生产，实际生产能力为 4.56 亿颗封装芯片。

（二）建设过程及环保审批情况

公司于 2026 年委托安徽环境科技研究院股份有限公司编制了《合肥通富微电子有限公司存储器芯片封装生产线扩产项目环境影响报告表》，并于同年 7 月 16 日经合肥市生态环境局审批（环建审【2026】11044 号）。公司于 2025 年 12 月 4 日变更排污许可证，重点管理证书编号：9134010032803903XA001U。

（三）投资情况

环评计划总投资 25000 万元，本次验收项目实际总投资 20000 万元，其中环保投资 10 万元，占总投资额的 0.05%。

（四）验收范围

本次验收针对存储器芯片封装生产线扩产项目进行竣工环境保护“三同时”验收，本次验收实际生产能力为 4.56 亿颗封装芯片。

二、工程变动情况

原环评中设置新增153台键合机、6台老化炉，实际新增165台键合机、1台键

合机后AOI、7台老化炉。新增辅助设备，不涉及上述情形，不新增污染物种类，不新增废水污染物。对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施未发生变动），本次验收项目实际建设情况与环评及批复对比，未发生变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本次验收废水主要为一般清洗废水、生活污水、纯水制备产生的浓水、冷却循环废水。

（二）清洗废水经预处理装置处理后通过中水回用系统再次制取纯水，回用于生产，中水回用系统产生的浓水、纯水站浓水排放至厂区污水处理总站处理后与经化粪池、隔油池预处理的生活污水、冷却循环废水一起排入经开区污水处理厂，处理达标后排入丙子河。

（三）废气

本次验收产生的废气主要为基板刷胶、基板烘烤、装片固化、塑封、后固化、植球工段、维修间进行热压板清洗产生的挥发性有机废气（非甲烷总烃、异丙醇）以及植球产生的锡及其化合物，辅助工序新增污泥烘干产生的废气（氯化氢、硫化氢、氨、臭气浓度）。

基板刷胶、基板烘烤、装片固化、塑封、后固化、植球工段、维修间进行热压板清洗废气密闭收集后，经 1 套二级活性炭吸附处理装置（TA004）处理后，经 1 根 25 米高的排气筒（DA004）排放。

污泥烘干废气经密闭空间侧吸风收集后引入生物除臭装置处理后，经 1 跟 20m 高排气筒（DA005）排放。

（三）噪声

本次验收噪声主要是水清洗机、烘箱、打包机等设备产生的噪声，声级值为70~90dB（A）。通过选用低噪设备，设置减振基座，设置单独设备房，厂房隔声等措施降噪。

（四）固体废物

厂区产生的固体废物主要为生活垃圾、一般固废、危险废物：

生活垃圾：生活垃圾年产生量约为 288.84t，交由环卫部门处理；

一般固体废物：废纸盒产生量为231.1t/a、黑胶木产生量为351.02t/a、 塑料盒产生量为16.4t/a、废膜产生量为10.12t/a、不合格品产生量为6.56t/a、废塑封料产生量为47.96t/a、废边角料产生量为4.95t/a、废管式膜产生量为0.376t/a，集中收集后交由物资单位回收处理；废焊球产生量为0.45t/a、废钢带产生量为1.7t/a、废滤网产生量为1.3t/a，集中收集后交由原厂回收处理。

危险废物：重金属污泥产生量为58.851t/a、废活性炭产生量为3.52t/a、废包装桶产生量为17.70t/a、废胶瓶产生量为0.19t/a、废油产生量为1.547t/a、废变压器油产生量为1t/a、废RO膜产生量为1t/a、废滤渣产生量为1t/a、沾染物产生量为5.84t/a、废电镀液（废表面处理液）产生量为19.99t/a、废解析液产生量为2.708t/a、废酒精产生量为5t/a、实验室废液产生量为0.4t/a、废助焊剂产生量为1t/a。厂区内共建设了2处危废库用于存放危废废物，地面均进行了防腐防渗处理。1#危废库位于固废站内南侧，建筑面积300m^2。2#危废库位于化学品库外东侧，建筑面积75m^2。

通过采取以上措施，本次验收项目产生的固体废物均得到妥善处置。

（五）根据本项目环评及批文要求，本项目无环境防护距离要求。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水：根据安徽亿盛检测技术有限公司提供的检测报告（报告编号：AHYS2608087）可知，验收监测期间，厂区废水总排口处废水pH值范围为7.1-7.6；COD日均浓度均为66.5mg/L；BOD_5日均浓度分别为17.25mg/L、17.48mg/L；氨氮日均浓度分别为2.72mg/L、2.96mg/L；SS日均浓度分别为44.5mg/L、45mg/L；总磷日均浓度分别为0.30mg/L、0.31mg/L；总氮日均浓度分别为10.18mg/L、10.35mg/L；动植物油日均浓度分别为0.34mg/L、014mg/L。废水中污染物排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表1水污染物排放限值、经开区污水处理厂接管浓度限值。

2、废气：根据安徽亿盛检测技术有限公司提供的检测报告（报告编号：AHYS2608087）可知，验收监测期间，DA004排气筒非甲烷总烃最大排放浓度、最大排放速率分别为4.32mg/m^3、0.1kg/h，异丙醇未检出，均满足《固定源挥发

性有机物综合排放标准 第 5 部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024）表 1、2 中的排放限值（非甲烷总烃最大允许排放浓度为 5mg/m^3、最大允许排放速率为 5.0kg/h；异丙醇最大允许排放浓度为 40mg/m^3）；锡及其化合物最大排放浓度、最大排放速率分别为 6.7×10^{-5}mg/m^3、1.43×10^{-6}kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的排放限值（锡及其化合物最大允许排放浓度为 8.5mg/m^3、最大允许排放速率为 1.16kg/h）。DA005 排气筒氯化氢未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的排放限值（氯化氢最大允许排放浓度为 100mg/m^3、最大允许排放速率为 0.43kg/h）；硫化氢最大排放浓度、最大排放速率分别为 0.037mg/m^3、1.62×10^{-4}kg/h，氨最大排放浓度、最大排放速率分别为 1.49mg/m^3、6.36×10^{-3}kg/h，臭气浓度为 151（无量纲），均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 中标准值（硫化氢最大允许排放速率为 0.58kg/h；氨最大允许排放速率为 8.7kg/h；臭气浓度为 2000（无量纲））。

验收监测期间厂界非甲烷总烃最大排放浓度为 0.63mg/m^3，锡及其化合物未检出，氯化氢最大排放浓度为 0.07mg/m^3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中厂界无组织排放监控浓度限值要求（非甲烷总烃≦4.0mg/m^3，锡及其化合物≦0.24mg/m^3，氯化氢≦0.2mg/m^3）；硫化氢最大排放浓度为 0.008mg/m^3，氨最大排放浓度为 0.08mg/m^3，臭气浓度未检出，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中排放限值（硫化氢≦0.06mg/m^3，氨≦1.5mg/m^3，臭气浓度≦20）。

非甲烷总烃厂区内最大排放浓度为 0.78mg/m^3，满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 5 部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024）表 3 中厂区内 VOCs 无组织特别排放限值要求（非甲烷总烃≦6mg/m^3）。

3、噪声：根据安徽亿盛检测技术有限公司提供的检测报告（报告编号：AHYS2608087）可知，验收监测期间，项目区东、南、西、北侧厂界噪声昼间最大值为 64dB（A）、夜间最大值为 53.7dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准要求。

五、验收结论

合肥通富微电子有限公司存储器芯片封装生产线扩产项目环境保护审查、审

批手续完备，项目建设过程中总体按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，主要污染物达标排放，符合竣工验收条件。

六、后续要求

企业应加强对各项污染治理设施的日常运行维护管理，保障设施正常稳定运行，确保各项污染物稳定达标排放，开展持续的环境监测工作。

七、验收人员信息

见附表

合肥通富微电子有限公司